



2013年3月期 中間報告書
2012年4月1日～2012年9月30日

株式会社
デジタルメディアプロフェッショナル

証券コード：3652

株主のみなさまへ

株主のみなさまには、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2013年3月期中間期を終了いたしましたので、ここに「第11期中間報告書」をお届けいたします。ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長CEO 山本 達夫

2012年11月

第2四半期ハイライト

売上高

(対前年同期比26.3%減)

407,329千円

経常利益

(対前年同期比78.6%減)

41,521千円

第2四半期純利益

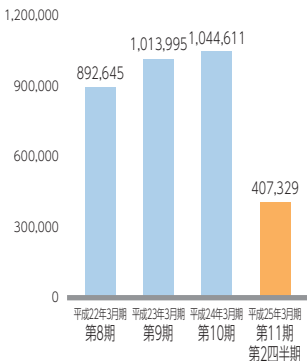
(対前年同期比76.6%減)

40,147千円

経営成績の推移

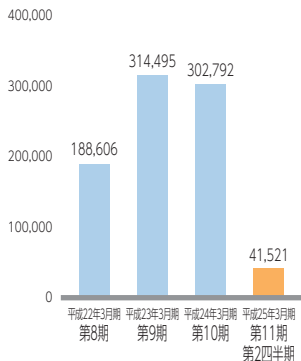
売上高

(単位：千円)



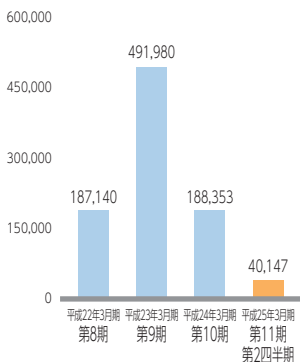
経常利益

(単位：千円)



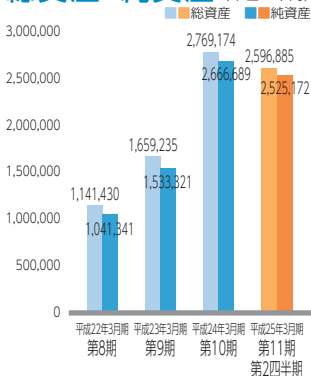
第2四半期(当期)純利益

(単位：千円)



総資産・純資産

(単位：千円)



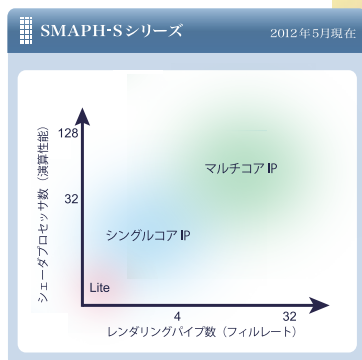
SMAPH-Sシリーズにマルチコア構成およびコンピューティングに対応した新しいOpenGL ES 2.0ハイエンドIPコアを発表 (2012年5月7日)

当社は、プログラマブルシェーダ機能を搭載した最先端の3D/2DグラフィックスIPコアSMAPH-Sシリーズを大幅に拡充し、業界で最も幅広い拡張性を誇るグラフィックスIPコアをラインナップに加えました。

SMAPH-Sのハイエンド構成は業界最高レベルのパフォーマンスと他社製品比2-4倍の省コア・省電力を実現します。



また、SMAPH-Sをベースに開発した世界最小クラスのOpenGL ES 2.0対応3DグラフィックスIPコアSMAPH-S Liteを発表。シェーダプロセッサ数を最小化および内部演算精度を最適化することでコアサイズを削減し、低コストなOpenGL ES 2.0対応IPコアを実現しました。

SMAPH-S Liteによる描画例



グラフィックスIPコア ラインナップ

	3Dグラフィックス	2Dベクタ グラフィックス	DMP拡張
SMAPH[®]-S Programmable Shader Core	OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 (NEW)	OpenVG 1.1	MESTRO
SMAPH[®]-S Lite World Smallest OpenGL ES 2.0 IP Core			
SMAPH[®]-H2 3D/2D Vector Hybrid Core			
SMAPH[®]-H 3D/2D Vector Hybrid Core			
SMAPH[®]-F 2D Vector Core			
PICA[®]200 Photorealistic 3D Core			
PICA[®]200 Lite Low cost 3D Core			

 標準装備
  オプション

これらの新製品に加え、SoCにおけるグラフィックスコアの性能を最大限に引き出すことを可能にするLoputo Platform IPシリーズを発表しております。

台湾において技術セミナーを開催(2012年9月12日)

営業面では本年6月に提携を発表した台湾III社と共同で、技術セミナーを開催しております。このセミナーには台湾の主要半導体関連企業のVIPを含む多数の方々にご参加いただきました。当社はこの技術セミナーを通じて、III社との連携強化を図るとともに、台湾市場での営業活動を強力に推進してまいります。



株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会・期末配当 毎年3月31日
	中間配当 毎年9月30日
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の 本店および全国各支店で行っております。
お問い合わせ	〒180-0006 東京都武蔵野市中町一丁目15番5号 三鷹高木ビル7階 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル TEL.0422-60-3480 http://www.dmprof.com/